

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Diffusion immédiate

Scintil Photonics lève 50 M€ (58 M\$) pour accélérer la photonique intégrée destinée aux usines d'IA

Un tour de table mené par Yotta Capital permettra à l'entreprise d'accélérer le déploiement de sa technologie de pointe en intégration photonique.

GRENOBLE, France / 9 septembre 2025 - Scintil Photonics, leader mondial des technologies de photonique hétérogène intégrée pour les infrastructures d'IA, annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série B de 50 millions d'euros (58 M\$), mené par Yotta Capital Partners et NGP Capital, avec la participation de NVIDIA. Ce tour de table inclut la participation de BNP Paribas Développement, aux côtés des investisseurs existants tels que Supernova Invest, Bpifrance Digital Venture, Innovacom, Bosch Ventures, Applied Ventures ITIC Innovation Fund (AVITIC), confirmant la confiance renouvelée dans la plateforme technologique et le potentiel de marché de l'entreprise, avec le soutien d'acteurs mondiaux et européens du deep tech.

Ce financement permettra à Scintil d'intensifier ses recrutements, d'élargir sa présence internationale, et d'accélérer la production du premier moteur optique monopuce DWDM-native de l'industrie, intégrant des lasers à multi-longueurs d'onde et autres composants photoniques, alignée avec la prochaine génération d'optique co-packagée (CPO) conçue pour les usines d'IA. Les solutions de Scintil sont spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de bande passante élevée et dense, de faible latence et permettent d'atteindre l'efficacité énergétique et les performances nécessaires aux clusters de GPU les plus puissants de demain.

« Cet investissement marque un tournant décisif pour Scintil, alors que nous passons à la phase de déploiement à grande échelle », déclare Matt Crowley, CEO de Scintil Photonics. « Notre technologie SHIP™ permet des solutions photoniques intégrées offrant la scalabilité, l'efficacité énergétique et la densité d'intégration nécessaires pour construire la prochaine génération d'infrastructures de calcul. Cette efficacité contribue non seulement à réduire les coûts d'exploitation des centres de données, mais aussi à diminuer l'empreinte carbone des infrastructures IA. Avec l'entrée en production à grande échelle de LEAF Light™, nous élargissons notre présence depuis Grenoble vers les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, afin de soutenir les usines d'IA les plus avancées au monde. »

« Nous avons développé notre circuit intégré LEAF-Light en étroite collaboration avec nos clients. Utilisé comme source laser externe pour les transmissions optiques embarquées (Co-Packaged Optics, CPO), il s'agit d'un composant clé pour la prochaine génération de centres de données IA. Sa particularité réside dans une solution monopuce, intégrant de manière monolithique des lasers DFB précisément espacés sur des circuits photoniques silicium, et produits via une chaîne d'approvisionnement commerciale robuste », a déclaré Sylvie Menezo, fondatrice et directrice technique de Scintil Photonics. « Notre technologie de circuit photonique intégré SHIP™ constitue un socle fort et disruptif pour faire évoluer notre portefeuille de solutions de circuits photoniques intégrés pour les prochaines décennies. »

« Scintil illustre parfaitement le type de leaders innovants que nous recherchons, alliant excellence industrielle, leadership deeptech et impact concret sur les besoins énergétiques de l'IA», déclare Vincent Deltrieu, Managing Partner chez Yotta Capital Partners. « La plateforme de photonique intégrée de Scintil est essentielle pour faire passer à l'échelle la prochaine génération des fabriques d'IA. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur expansion mondiale alors qu'ils passent à des livraisons en volume. »

« La photonique intégrée est en passe de devenir essentielle pour toute infrastructure d'IA, et Scintil est en train de transformer cet avenir en réalité », a déclaré Bo Ilsoe, associé directeur chez NGP Capital. « Leur technologie offre la densité de bande passante et l'efficacité énergétique dont les IA factories ont besoin, avec une scalabilité mondiale. Nous sommes ravis de soutenir Scintil dans ses déploiements et son ascension au rang d'acteur majeur de la construction de la prochaine vague d'infrastructures de centres de données pour l'IA»

Alan Weckel, cofondateur et analyste technologique chez 650 Group, a déclaré :

« À mesure que le nombre d'XPU et la demande en bande passante pour l'IA augmentent, les réseaux d'interconnexion des XPU devront progressivement abandonner le cuivre au profit de la fibre». Les centres de données spécialisés dans l'IA évolueront vers des solutions optiques co-packagées et des moteurs optiques DWDM externes. Le marché des réseaux d'interconnexion des XPU (scale-up) représente une nouvelle opportunité pour les fournisseurs, avec une prévision de plus de 25 milliards de dollars pour 2029. D'ici la fin de la décennie, le marché des infrastructures réseau pour l'IA devrait atteindre près de 100 milliards de dollars par an. Scintil se distingue par l'introduction d'une plateforme de fabrication alignée sur les procédés des fonderies de semi-conducteurs. La fiabilité et la capacité à passer rapidement à la production de volume sont les deux seuls moyens permettant aux opérateurs de centres de données de répondre à la demande d'IA qu'ils prévoient de déployer au cours de cette décennie. »

Daryl Inniss, Thought Lead of Optical Components and Advanced Fiber chez Omdia, a commenté : « L'optique co-packagée en DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) est un facteur différenciant qui permet de connecter des milliers de GPU tout en répondant aux exigences de densité de bande passante des infrastructures IA de nouvelle génération. La source laser DWDM monopuce de Scintil, fondée sur un procédé de photonique intégrée hétérogène, démontre comment cette capacité peut être mise en œuvre sur une plateforme industrialisable et évolutive. Cette avancée est essentielle alors que les usines d'IA se dirigent vers des clusters toujours plus vastes et des débits accrus. »

Conçu pour l'épine dorsale optique de l'IA

La technologie de procédé propriétaire SHIP™ (Scintil Heterogeneous Integrated Photonics) de Scintil permet l'intégration de multiples composants optiques, lasers, photodiodes et modulateurs, sur une seule puce. SHIP™ permet ainsi à Scintil de remplacer des dizaines de composants traditionnellement distincts par une solution monopuce offrant des niveaux de performance, d'efficacité et de densité d'intégration jusqu'ici inatteignables. Scintil est issue du CEA-Leti, un institut de recherche reconnu mondialement pour son expertise en technologies des semi-conducteurs, offrant à l'entreprise une avance décisive en intégration photonique

hétérogène sur silicium. Depuis sa création, Scintil a développé la plateforme SHIP™ sur une chaîne d'approvisionnement commerciale dotée de capacités de production de masse.

Le financement de série B soutient la montée en puissance commerciale de LEAF Light™, le premier moteur optique monopuce DWDM-native de l'industrie, aligné avec les exigences de la nouvelle génération d'optiques co-packagées (CPO). DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)-native signifie que cette monopuce peut générer de nombreuses longueurs d'onde, espacées de manière très précise, et multiplexées, afin d'augmenter considérablement la bande passante dans la fibre tout en réduisant les besoins énergétiques. En diminuant la consommation énergétique par bit, LEAF Light™ contribue à réduire l'empreinte carbone des centres de données IA.

Construit sur la plateforme SHIP™ de Scintil, LEAF Light™ offre une connectivité optique à faible consommation et à haute densité, avec une bande passante pouvant atteindre 6,4 Tbps/mm et une consommation énergétique environ six fois inférieure à celle des modules enfichables conventionnels. Il est conçu pour s'intégrer dans les clusters de GPU et les systèmes d'IA émergents, et sera accompagné d'implémentations de référence et une structure de support destinée à accélérer son déploiement.

Expansion mondiale depuis un pôle d'innovation

Ce tour de financement permet à Scintil d'accélérer ses recrutements et de renforcer sa présence aux États-Unis tout en poursuivant la croissance de son équipe à Grenoble, l'un des principaux pôles mondiaux d'innovation en photonique et en semi-conducteurs. Située au cœur de l'écosystème européen des semi-conducteurs avancés, Scintil bénéficie de la proximité d'institutions telles que le CEA-Leti ainsi que de grands acteurs mondiaux des semi-conducteurs présents dans la région, offrant un vivier de talents exceptionnel et un environnement propice à l'innovation collaborative.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le renforcement de la présence de l'entreprise aux États-Unis sera clé pour servir plus directement ses partenaires en infrastructures d'IA. Scintil recrute activement dans les domaines de la conception, de l'ingénierie, des opérations et du support client afin d'atteindre une production à grande échelle. Soutenue par des investisseurs de premier plan et approuvée par des pionniers de l'industrie, Scintil est prête à fournir les technologies optiques intégrées nécessaires pour les prochaines générations d'usines d'IA.

À propos de Scintil Photonics

Scintil Photonics, leader mondial des technologies d'intégration hétérogène en photonique intégrée sur silicium pour les infrastructures d'IA. Grâce à son procédé propriétaire d'intégration hétérogène, SHIP™, Scintil permet des interconnexions optiques hautes performances répondant aux exigences de puissance et de bande passante des clusters de GPU, rendues possibles par l'émergence d'optiques co-packagées. Le produit de Scintil, LEAF Light™, est un moteur optique monopuce DWDM-native, conçu pour une connectivité optique à haute densité. Basée à Grenoble, en France, et dotée d'opérations en Amérique du Nord, Scintil poursuit son expansion mondiale afin d'accompagner l'évolution des besoins en infrastructures IA.

www.scintil-photonics.com

Contacts presse :

Isaac Lopez

OmniScale Media

+1 360-576-5475

isaac@omniscalemedia.com

###